



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6346.1401—2025/IEC 60384-14-1:2016

代替 GB/T 6346.1401—2015

## 电子设备用固定电容器 第 14-1 部分：空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 DZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—  
Part 14-1: Blank detail specification—Fixed capacitors for electromagnetic  
interference suppression and connection to the supply mains—  
Assessment level DZ

(IEC 60384-14-1:2016, IDT)

2025-12-31 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	VI
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 一般资料 .....	1
5 检验要求 .....	3
附录 A (规范性) 设计申报 .....	8
参考文献 .....	9

## 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《电子设备用固定电容器》的第 14-1 部分。《电子设备用固定电容器》已经发布了以下部分:

- 第 1 部分:总规范(GB/T 6346.1—2024);
- 第 2 部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011);
- 第 2-1 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质 直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012);
- 第 3 部分:分规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器(GB/T 6346.3—2015);
- 第 3-1 部分:空白详细规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.301—2015);
- 第 4 部分:分规范 固体和非固体电解质铝电容器(GB/T 5993—2003);
- 第 4-1 部分:空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平 E(GB/T 5994—2003);
- 第 5 部分:分规范 额定电压不超过 3 000 伏的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和一般要求(GB/T 6261—1998);
- 第 5 部分:空白详细规范 额定电压不超过 3 000 伏的直流云母介质固定电容器 评定水平 E(GB/T 6262—1998);
- 第 6 部分:分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用)(GB/T 14004—1992);
- 第 6 部分:空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 14005—1992);
- 第 7 部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012);
- 第 7-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186—2012);
- 第 8 部分:分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011);
- 第 8-1 部分:空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011);
- 第 9 部分:分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011);
- 第 9-1 部分:空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012);
- 第 11 部分:分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(GB/T 6346.11—2015);
- 第 11-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.1101—2015);
- 第 13 部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10188—2013);
- 第 13-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10189—2013);
- 第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 6346.14—2023);
- 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 DZ(GB/T 6346.1401—2025);

- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003);
- 第 15 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(可供认证用) (GB/T 12794—1991);
- 第 15 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用) (GB/T 12795—1991);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ (GB/T 10191—2011);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 14580—2013);
- 第 18 部分:分规范 固体( $MnO_2$ )与非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998);
- 第 18 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体( $MnO_2$ )电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 17207—2012);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 15448—2013);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 16467—2013);
- 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21038—2007);
- 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21040—2007);
- 第 23 部分:分规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(6346.23—2025);
- 第 23-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(6346.2301—2025);
- 第 24 部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器(GB/T 6346.24—2021);
- 第 25 部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器(GB/T 6346.25—2018);
- 第 25-1 部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 6346.2501—2018);
- 第 26 部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器(GB/T 6346.26—2018);
- 第 26-1 部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 6346.2601—2018)。

本文件代替 GB/T 6346.1401—2015《电子设备用固定电容器 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D》。与 GB/T 6346.1401—2015 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

- a) 将“评定水平 D”更改为“评定水平 DZ”,更改了表 4 及表 5 中检验水平 IL 值、合格判定数 c

(见表 4、表 5,2015 年版的表 4、表 5);

- b) 删除了可焊性试验方法 3 焊球法(见 2015 年版的表 4 中 4.5、表 5 中 4.5);
- c) 将“干热”更改为“高温”(见表 5 中 4.11.2,2015 年版的表 5 中 4.11.2);
- d) 将“循环湿热”更改为“交变湿热”(见表 5 中 4.11.3、4.11.5,2015 年版的表 5 中 4.11.3、4.11.5);
- e) 将“寒冷”更改为“低温”(见表 5 中 4.11.4,2015 年版的表 5 中 4.11.4);
- f) 将“稳态湿热”更改为“恒定湿热”(见表 5 中 4.12,2015 年版的表 5 中 4.12);
- g) 增加了规范性附录“设计申报”(见附录 A)。

本文件等同采用 IEC 60384-14-1:2016《电子设备用固定电容器 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电磁干扰和电源连接用固定电容器 评定水平 DZ》。

本文件增加了“范围”“规范性引用文件”和“术语和定义”3 章。并将 IEC 60384-14-1:2016 的“1.4 规范性引用文件”的内容调到第 2 章,后续章条号顺序前移。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动:

- a) 按上层文件 IEC 60384-14 要求增加了“紧跟一个字母表示阻燃性类别”(见 4.3);
- b) 表 5 中 C1A 组的“4.4.1 初始测量”错误,本文件更正为“初始测量”(见表 5 中 4.1);
- c) 由于 IEC 60068-2-20:2008 及上层总规范文件 IEC 60384-1:2016 已经删除了可焊性试验方法 3 焊球法,但本文件的原文未做相应删除,故本文件删除了可焊性试验方法 3(见表 4、表 5 中 4.5)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本文件起草单位:厦门法拉电子股份有限公司、中国电子技术标准化研究院。

本文件主要起草人:黄顺达、林晋涛、刘学孔、兰劭涵。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

- 1993 年首次发布为 GB/T 14473—1993,1998 年第一次修订;
- 2015 年第二次修订,编号调整为 GB/T 6346.1401—2015;
- 本次为第三次修订。

## 引　　言

### 空白详细规范

#### 0.1 概述

电子设备用固定电容器属于电子信息产业中广泛应用的基础元件,制定本系列文件能指导行业更加有效地解决对电子设备用固定电容器的产品质量评价问题。

电子设备用固定电容器分门类或型号较多,对应的 IEC 60384(所有部分)是分为不同部分编写,为保持与 IEC 标准编写方法一致,加之对不同分门类或型号固定电容器的技术要求也不同,在编制时需单列不同部分进行编制。

《电子设备用固定电容器》由总规范、分规范、空白详细规范和详细规范分层体系构成,系列文件拟由以下部分构成。

- 第 1 部分:总规范。目的是规定了电子设备用固定电容器门类的大部分共同的所有项目,术语、检验程序和试验方法。
- 第 2 部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 2-1 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质 直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ。目的在于确立评定水平为 E 和 EZ 的金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 3 部分:分规范 表面安装  $MnO_2$  固体电解质钽固定电容器。目的在于确立表面安装  $MnO_2$  固体电解质钽固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 3-1 部分:空白详细规范 表面安装  $MnO_2$  固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装  $MnO_2$  固体电解质钽固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 4 部分:分规范 固体和非固体电解质铝电容器。目的在于确立固体和非固体电解质铝电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 4-1 部分:空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的非固体电解质铝电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 5 部分:分规范 额定电压不超过 3 000 伏的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和一般要求。目的在于确立额定电压不超过 3 000 V 的直流云母介质固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 5 部分:空白详细规范 额定电压不超过 3 000 伏的直流云母介质固定电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的额定电压不超过 3 000 V 的直流云母介质固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细

规范的编制导则。

——第 6 部分:分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

——第 6 部分:空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。

——第 7 部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

——第 7-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。

——第 8 部分:分规范 1 类瓷介固定电容器。目的在于确立 1 类瓷介固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

——第 8-1 部分:空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的 1 类瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。

——第 9 部分:分规范 2 类瓷介固定电容器。目的在于确立 2 类瓷介固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

——第 9-1 部分:空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的 2 类瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。

——第 11 部分:分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

——第 11-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。

——第 13 部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

——第 13-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ。目的在于确立评定水平为 E 和 EZ 的金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。

——第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器。目的在于确立抑制电源电磁干扰用固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

- 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 DZ。目的在于确立评定水平为 DZ 的抑制电源电磁干扰用固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 14-2 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 仅安全试验。目的在于确立仅安全试验的抑制电源电磁干扰用固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器。目的在于确立非固体或固体电解质钽固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 15 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的非固体电解质箔电极钽电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 15 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的非固体电解质多孔阳极钽电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的固体电解质和多孔阳极钽电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ。目的在于确立评定水平为 E 和 EZ 的金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器。目的在于确立金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 E 和 EZ。目的在于确立评定水平为 E 和 EZ 的金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 18 部分:分规范 固体( $MnO_2$ )与非固体电解质片式铝固定电容器。目的在于确立固体( $MnO_2$ )和非固体电解质片式铝固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 18 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平 E。目的在于确立评定水平为 E 的非固体电解质片式铝固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体( $MnO_2$ )电解质铝固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装固体( $MnO_2$ )电解质铝固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制

导则。

- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 20 部分:分规范 表面安装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器。目的在于确立表面安装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器。目的在于确立表面安装 1 类多层瓷介固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装 1 类多层瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器。目的在于确立表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 23 部分:分规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 23-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 24 部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器。目的在于确立表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 24-1 部分:空白详细规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 25 部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器。目的在于确立表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适

用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

- 第 25-1 部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 第 26 部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器。目的在于确立导电高分子固体电解质铝固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
- 第 26-1 部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ。目的在于确立评定水平为 EZ 的导电高分子固体电解质铝固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
- 各型号详细规范。目的是完整地规定了固定电容器的一个给定的型号和范围,包括所有规格尺寸和特性值的要求。也给出在合适的质量评定体系内固定电容器覆盖的型号和范围的质量评定所需的所有信息,包括所有应用的试验严酷等级和接收判据的要求以及完整的试验一览表。详细规范既是在国家标准体系内的规范,也是与国家标准体系相联系的行业规范,或是由制造商或用户制定的规范。

本文件形成了共同的国际安全标志的统一程序的基础。它落实 GB/T 6346.14 安全试验认证一览表,要求相关安全性参数的设计申报,指明在每一个批放行前进行一致性试验,并且重新鉴定试验取决于申报的设计的变更。

本文件提供了评定水平 DZ(零缺陷)。

本文件适合于大批量生产制造元件的使用,然而在进行认证和鉴批准定试验对产品成本有重大影响的情况下,有必要使用 IEC 60384-14-2(仅安全试验)。

空白详细规范是分规范的一种补充文件,它包括对详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范不能被认为是符合国家标准要求的详细规范。

在制定详细规范时参考分规范 GB/T 6346.14—2023 中 1.4 的内容。

## 0.2 详细规范和电容器的识别

详细规范的第一页如图 1 的排版。括号中数字对应于下列内容,并填写在指定的位置上。

- (1) 授权起草本详细规范的组织:国家标准化管理委员会。
- (2) 国家标准的详细规范编号、发布日期以及需要的其他内容。
- (3) 国家标准的有关总规范或分规范编号及其版本号。
- (4) 国家标准的空白详细规范编号、发布日期以及需要的其他内容,连同任何修改单号。

## 0.3 电容器的识别

- (5) 电容器型号或电容器范围的简要说明,说明的文本满足 IECQ 认证要求的内容。
- (6) 典型结构的说明(适用时),说明的文本满足 IECQ 认证要求的内容。
- (7) 标有影响互换性的主要尺寸的外形图和/或引用国家或国际的外形方面的文件。此外,这种图也能在详细规范附录中给出。但(7)始终包含元件的一般外观的说明。
- (8) 适用时,详细规范覆盖的质量评定水平。
- (9) 元件最重要特性的参考数据,以便相同或类似应用的各种不同型号元件之间进行比较。

	(1)	GB/T 6346.1401—2025	(2)
电子元器件质量评定按 GB/T 6346.1 GB/T 6346.14	(3)	GB/T 6346.1401	(4)
外形图(见表 1) (第一角视图)	(7)	抑制电源电磁干扰用固定电容器 (评定水平 DZ)	(5)
(在给定尺寸范围内允许形状有所不同)		典型结构(示例):	(6)
		类/分类 评定水平 DZ	(8)
按本详细规范鉴定合格的元件的有效资料在鉴定合格产品一览表中给出			(9)

图 1 详细规范第一页排版

电子设备用固定电容器  
第 14-1 部分: 空白详细规范  
抑制电源电磁干扰用固定电容器  
评定水平 DZ

## 1 范围

本文件规定了抑制电源电磁干扰用固定电容器基于评定水平 DZ 的安全和性能检验的要求。  
本文件适用于抑制电源电磁干扰用固定电容器。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6346.14—2023 电子设备用固定电容器 第 14 部分: 分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(IEC 60384-14:2013, IDT)

IEC 61193-2:2007 质量评定体系 第 2 部分: 电子元器件和包装检验用抽样方案的选择和使用  
(Quality assessment systems—Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages)

注: GB/T 33772.2—2025 质量评定体系 第 2 部分: 电子元器件及封装件检验用抽样方案的选择和使用  
(IEC 61193-2:2007, MOD)

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 一般资料

### 4.1 推荐的安装方法

按 GB/T 6346.14—2023 中 1.4.2 的规定。

### 4.2 尺寸

尺寸在表 1 中给出。